

20034407-01

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月28日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-089899

[ST. 10/C]:

Applicant(s):

[JP2003-089899]

出 願 人

ブラザー工業株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 9月30日





【書類名】

特許願

【整理番号】

2002020100

【提出日】

平成15年 3月28日

【あて先】

特許庁長官

殿

【国際特許分類】

B41J 2/00

【発明者】

【住所又は居所】

名古屋市瑞穂区苗代町15番1号

ブラザー工業株式会社内

【氏名】

片山 直樹

【特許出願人】

【識別番号】

000005267

【氏名又は名称】 ブラザー工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100104178

【弁理士】

【氏名又は名称】 山本 尚

【電話番号】

052-889-2385

【選任した代理人】

【識別番号】

100109195

【弁理士】

【氏名又は名称】 武藤 勝典

【選任した代理人】

【識別番号】

100119611

【弁理士】

【氏名又は名称】 中山 千里

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

052478

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9722914

【包括委任状番号】 0018483

【プルーフの要否】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 記録装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の記録素子を有し、記録媒体に対し記録を行う記録へッドと、

当該記録ヘッドを保持するヘッドホルダと、

当該ヘッドホルダの外側面に沿って設けられ、可撓性を有する帯状絶縁体上に 複数の導線及び前記記録ヘッドを駆動する駆動素子を備えたフレキシブル配線基 板と、

当該駆動素子で発生した熱を外部へ放出するヒートシンクとを備え、

当該ヒートシンクは、前記駆動素子が設けられたフレキシブル配線基板の面と 反対側の面の前記駆動素子に対向する位置に密着されていることを特徴とする記 録装置。

【請求項2】 前記フレキシブル配線基板を保護するために前記ヘッドホル ダに設けられたカバーと、

前記駆動素子と前記カバーとの間に設けられた弾性部材と を備え、

前記ヒートシンクは、前記フレキシブル配線基板と前記ヘッドホルダとの間に 設けられ、

前記弾性部材の押圧力により、前記駆動素子は前記フレキシブル配線基板を挟んで前記ヒートシンクに押圧されていることを特徴とする請求項1に記載の記録 装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、記録装置に関し、詳細には、記録媒体に対し記録を行う記録ヘッド と当該記録ヘッドを駆動する駆動素子と当該駆動素子からの信号を記録ヘッドに 伝えるフレキシブル配線基板を備えた記録装置に関する。 [0002]

【従来の技術】

従来、紙等の記録媒体に記録を行う記録装置として、例えば、インクジェット ヘッドのノズルからインクを記録媒体に噴射して印刷記録を行うインクジェット 記録装置が知られている。この種のインクジェット記録装置では、記録領域に沿 って往復移動可能なキャリッジを設け、このキャリッジに装着するヘッドホルダ に、インクジェットヘッド、これに駆動信号を供給する回路基板及びその両者を 接続するフレキシブル配線基板を配置している(例えば、特許文献1参照)。

[0003]

近年、ノズル数が増加し、かつ高密度になるのにともない、駆動信号を生成するドライバICとインクジェットヘッドを結ぶ配線も細線化しかつ高密度になって、配線上の信号がノイズの影響を受けやすくなり、また回路基板とフレキシブル配線基板との配線の接合箇所が増大するようになった。このため、ドライバICをインクジェットヘッドとをできるだけ接近させるように、フレキシブル配線基板上にドライバICを搭載するようになった(例えば、特許文献2参照)。

[0004]

一方、ノズル数の増加にともない、ドライバICの発熱量も多くなって、この 熱を放出するために、フレキシブル配線基板を覆う蓋板に、ドライバICをスポンジ等の弾性部材により押圧して接触させ、蓋板にヒートシンク機能をもたせて いる(上記特許文献 2 参照)。

[0005]

【特許文献1】

特開平11-10850号公報

【特許文献2】

特開2002-240306号公報

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特許文献2の記録装置では、組み立て時に、ヒートシンクとドライバICチップとの密着面に異物が挟まってしまうことがあった。この場合に

は、ドライバICチップはヒートシンクに弾性部材により押圧されるため、ドライバICチップに局所的な力が掛かり、ドライバICチップが破損することがあった。また、ヒートシンクとドライバICチップとの間に異物が介在するとこれらの密着が悪くなり、ドライバICチップからヒートシンクへの熱伝導が低下するという問題点もあった。さらに、ドライバICチップの表面がグランド電極となっているので、印字に影響する電気的ノイズが発生した場合には、ヒートシンクを介して、当該ノイズが他のドライバICチップにも伝播するという問題があった。

[0007]

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、ドライバICチップとヒートシンクとの間に異物が介在しても、ドライバICチップの破損を防止でき、また、これらの密着性を高め、ドライバICチップの放熱効果を良好に達成することができる記録装置を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するための請求項1に係る発明の記録装置は、複数の記録素子を有し、記録媒体に対し記録を行う記録ヘッドと、当該記録ヘッドを保持するヘッドホルダと、当該ヘッドホルダの外側面に沿って設けられ、可撓性を有する帯状絶縁体上に複数の導線及び前記記録ヘッドを駆動する駆動素子を備えたフレキシブル配線基板と、当該駆動素子で発生した熱を外部へ放出するヒートシンクとを備え、当該ヒートシンクは、前記駆動素子が設けられたフレキシブル配線基板の面と反対側の面の前記駆動素子に対向する位置に密着されていることを特徴とする構成となっている。

[0009]

この構成の記録装置では、ヒートシンクは、駆動素子が設けられたフレキシブル配線基板の面と反対側の面の駆動素子に対向する位置に密着されており、ヒートシンクがフレキシブル配線基板に密着する面に異物が介在しても、フレキシブル配線基板は可撓性を有する絶縁体であるので、当該異物は、フレキシブル配線基板の面にめり込みヒートシンクは駆動素子が設けられたフレキシブル配線基板

の面と反対側の面に密着することができる。

[0010]

また、請求項2に係る発明の記録装置では、請求項1に記載の記録装置の構成に加えて、前記フレキシブル配線基板を保護するために前記ヘッドホルダに設けられたカバーと、前記駆動素子と前記カバーとの間に設けられた弾性部材とを備え、前記ヒートシンクは、前記フレキシブル配線基板と前記ヘッドホルダとの間に設けられ、前記弾性部材の押圧力により、前記駆動素子は前記フレキシブル配線基板を挟んで前記ヒートシンクに押圧されていることを特徴とする構成となっている。

[0011]

この構成の記録装置では、請求項1に記載の発明の作用に加えて、フレキシブル配線基板とヘッドホルダとの間に設けられたヒートシンクに対して、ヘッドホルダに設けられたカバーと駆動素子との間に設けられた弾性部材の押圧力により、駆動素子はフレキシブル配線基板を挟んでヒートシンクに押圧される。

[0012]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の記録装置の一実施の形態について図面に沿って説明する。まず、本発明の記録装置の一実施の形態であるインクジェットプリンタ1の内部構成について、図1を参照して説明する。図1は、インクジェットプリンタ1の内部構造を示す斜視図である。

[0013]

図1に示すように、インクジェットプリンタ1の筐体2の内部には、記録媒体である記録用紙Pの幅方向に往復移動するキャリッジ8が設けられている。このキャリッジ8は、筐体2の長手方向に延設されたガイドロッド11及びガイド部材12に、各々スライド可能に支持されている。また、キャリッジ8は、筐体2の長手方向に張架された無端ベルト13に固着され、CRモータ16により無端ベルト13が駆動されると、キャリッジ8は、ガイドロッド11に沿って往復移動される。

[0014]

前記キャリッジ8には、印字等の記録を行うための記録へッド19,20,2 1,22(図2参照)を有する記録ヘッドユニット17が取り付けられている。 この記録ヘッド19~22は、4色のインク(シアンc、マゼンタm、イエロー y、ブラックb)を記録媒体である記録用紙P上に、インク液滴を噴射して記録 動作を行うインクジェット方式であり、その記録用紙P側に、前記各色のインク を各々噴射するために、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの噴射ノズル群 7a~7h(図2参照)を備えている。

[0015]

また、記録ヘッドユニット17には、各噴射ノズル群7a~7hに、各色のインクを供給する4つのインクカートリッジ14g,14m,14c,14bが着脱可能に搭載されている。また、本実施の形態のインクジェットプリンタ1では、記録ヘッド19~22と対向する位置には、記録用紙Pを搬送するプラテンローラ10が設けられ、プラテンローラ10は、図示外のラインフィードモータの駆動により回転駆動され、プラテンローラ10の回転によって、記録用紙Pがキャリッジ8の移動方向と直交する用紙搬送方向に搬送されるようになっている。

[0016]

次に、図2及び図3を参照して、記録ヘッドユニット17の構造について説明する。図2は、記録ヘッドユニット17を、その底部の背面側から見た斜視図であり、図3は、記録ヘッドユニット17から樹脂カバー24を取り去った状態を示す斜視図である。図2に示すように、記録ヘッドユニット17は、樹脂製のヘッドホルダ18に、プレート型圧電アクチュエータから構成された記録ヘッド19~22に対応した長方形の開口部を備えた金属製のヘッドカバー25と、回路基板26と、ヒートシンク27と、樹脂カバー24等が組み付けられて構成されている。また、図3に示すように、記録ヘッド19~22と回路基板26とは、フレキシブル配線基板31、32、33、34により各々接続されている。そして、図2に示すように、これらのフレキシブル配線基板31~34を保護するために樹脂カバー24がフレキシブル配線基板31~34を覆うように固定されている。また、ヘッドホルダ18は、図1に示すキャリッジ8に保持され、キャリッジ8と共に

ガイドロッド11に沿って往復運動を行うことができる。

[0017]

次に、図4及び図5を参照して、ヘッドホルダ18の構造を説明する。図4は、記録ヘッドユニット17の分解斜視図であり、図5は、ヘッドホルダ18の斜視図である。図4及び図5に示すように、ヘッドホルダ18は、合成樹脂材料で一体成形され、底壁18aと背壁18bと左側壁18cと右側壁18dと前壁18eとから構成され、上面が開放された略箱型形状に形成されている。尚、背壁18b、左側壁18c、右側壁18d及び前壁18eは、各々底壁18aから重力方向とは反対方向に延設されている。

[0018]

前述したインクカートリッジ14g,14m,14c,14bは、ヘッドホルダ18の上記開放部に着脱可能に搭載される。また、図4に示すように、ヘッドホルダ18の底壁18aの外側面には、ヘッド保持部28が凸出して形成されており、当該ヘッド保持部28には、記録用紙Pに対して記録を行う4個の記録ヘッド19~22が並置して接着固定され、その外側にヘッドカバー25が外嵌されている。さらに、背壁18bの外側面には、ヒートシンク27が接着固定され、そのヒートシンク27から所定間隔(一例として、3mm)離間して、記録ヘッド19~22とキャリッジ8側の配線基板(図示外)との中継基板となる回路基板26が固定されるようになっている。

$[0\ 0\ 1\ 9]$

また、図5に示すように、ヘッドホルダ18の底壁18aには、インクカートリッジ14y,14m,14c,14bの、インク放出部(図示外)に接続することができるインク供給通路19a,20a,21a,22aが穿設されている。各インク供給通路19a~22aは底壁18aを貫通してヘッド保持部28に開口しており、各記録ヘッド19~22の各噴射ノズル群7a~7hに対応したインク流路に接続されている。

[0020]

また、図4に示すように、ヘッドホルダ18の背壁18bの外側面の左右両端部の中央の近傍には、円筒型ボス18f, 18gが形成されている。このボス1

8 f, 18gを利用して図示外のビスにより回路基板26を背壁18bと間隔をおいて固定するようになっている。また、図4に示すように、ヘッドホルダ18の背壁18bの外周には、凸部18j、凸部18k、凸部18mがそれぞれ形成

[0021]

されている。

尚、キャリッジ8には、図示外の配線基板が設けられ、当該配線基板は、プリンタの筐体2内に固定された本体側制御基板(図示外)にフレキシブル配線基板(図示外)を介して接続され、そして、配線基板の接続部(図示外)が、ヘッドホルダ18に設けられた回路基板26のコネクタ41(図2参照)と接続されて、本体側制御基板からキャリッジ8の配線基板を介して回路基板26に電源や信号が供給されるようになっている。

[0022]

記録ヘッド19~22は、前記特許文献2に記載のヘッドと同様の公知の構造のもので、噴射ノズル7a~7hに連通した多数のインク室を有するキャビティプレートに、各インク室に対応した電極を有するプレート型の圧電アクチュエータを重ねた構造で、各電極への選択的な駆動信号の印加により、噴射ノズル7a~7hからインクを液滴として噴射することができる。フレキシブル配線基板31~34は、公知のものと同様に、可撓性を有する帯状絶縁体(一例として、ポリイミド樹脂)上に複数の導線が形成された構造で、圧電アクチュエータ上に各導線を電極と接続して固定されている。各フレキシブル配線基板31~34のヒートシンク27側とは反対側の面には、駆動素子としてICチップ35~38が搭載されている。ICチップ35~38は、本体側の制御回路からシリアル転送されてきた駆動波形信号を、圧電アクチュエータの各電極に対応したパラレル信号に変換しかつ所定の電圧値に変換して各電極に接続した導線に出力するものである。

[0023]

次に、図3及び図4を参照して、回路基板26の構造を説明する。回路基板26は、ガラスエポキシ等の剛体製基板から構成され、回路基板26上には、銅薄膜から構成された多数の配線及び、電解コンデンサ43,44と、コネクタ41

, 42等が設けられている。

[0024]

次に、図4及び図6を参照して、ヒートシンク27の構造を説明する。図6は、ヒートシンク27の平面図である。図4及び図6に示すように、ヒートシンク27は、放熱効率の高い金属であるアルミ板から形成され、平面視、略長方形で、その一部を屈曲させて、側面視「くの字」状に形成され、前記ICチップ35~38の当接部27kが形成されている。また、図6に示すように、ヒートシンク27の表面には、ヒートシンク27の外側に固定される回路基板26に半田付けされた電子部品の足や回路基板26のヒートシンク27側に設けられた電子部品との干渉を避けるために、凹部27a,27b,27c,27dが形成されている。また、凹部27dの中央には、貫通孔27eが形成されている。尚、この凹部27a,27b,27cは、開孔部としても良い。

[0025]

さらに、図6に示すように、ヒートシンク27の外周をなす各辺部には、切欠部27g、切欠部27h、切欠部27f、切欠部27i、切欠部27jがそれぞれ形成されている。

[0026]

次に、図2~図4、図7及び図8を参照して、ヘッドホルダ18への回路基板26、ヒートシンク27及び樹脂カバー24の取り付けの詳細について説明する。図7は、A-A、線における断面図であり、図8は、A-A、線における断面のICチップ38近傍の拡大断面図である。図2~図4、図7及び図8に示すように、ヘッドホルダ18の背壁18b側へは、まず、ヒートシンク27が固定される。このときに、ヒートシンク27の貫通孔27e、切欠部27fには、ボス18f、18gが貫通し、切欠部27g、27h、27iには、ヘッドホルダ18の凸部18j、18k、18mが各々嵌合する。そして、ヒートシンク27は、凸部18j、18k、18mの近傍に接着固定される。尚、図3に示すように、ヒートシンク27の当接部27kの熱がヘッドホルダ18に伝わらないようになっている。また、ヒートシンク27とヘッドホルダ18の

背壁18bの間にも所定距離(一例として、約3mm)の隙間が形成されている。従って、ヒートシンク27から外側への放熱以外に、この隙間にも、ヒートシンク27からの放熱が可能となっている。

[0027]

次に、図3に示すように、ヘッドホルダ18のヘッド保持部28に記録ヘッド19,20,21,22が接着固定され、ヒートシンク27の外側に沿って、回路基板26がボス18f,18gに図示外のネジを利用して固定される。このときに、フレキシブル配線基板31~34は、ヒートシンク27の当接部27k上に当接する。また、回路基板26とヒートシンク27の間には所定距離の隙間が形成される。次いで、図2に示すように、フレキシブル配線基板31~34を破損から防止するために、フレキシブル配線基板31~34上を覆うように、樹脂カバー24がヘッドホルダ18に接着固定される。尚、樹脂カバー24の裏面には、図8に示すように、ICチップ35~38に当接して、当該ICチップ35~38を押圧する弾性部材であるスポンジ50が接着されて設けられている。従って、樹脂カバー24をヘッドホルダ18に接着固定すると、弾性部材であるスポンジ50が圧縮され、ICチップ35~38を押圧する。

[0028]

従って、図8に示すように、樹脂カバー24のスポンジ50がICチップ35~38を各々押圧し、ICチップ35~38は、熱伝導の良い薄板の樹脂であるポリイミド樹脂からなるフレキシブル配線基板31~34を介して、ヒートシンク27の当接部27kに押圧される。従って、記録ヘッド19~22の駆動によりICチップ35~38で発生した熱はフレキシブル配線基板31~34を介して、ヒートシンク27の当接部27kから従来のヒートシンクに比べて、広い面積及び大きな体積を有するヒートシンク27全体に伝導され空気中に放熱される

[0029]

尚、図7及び図8に示すように、ヒートシンク27とヘッドホルダ18の背壁 18bとは、所定間隔(一例として、3mm)離間しており、また、ヒートシン ク27と回路基板26との間も所定間隔(一例として、3mm)離間しており、 ヒートシンク27からの放熱が妨げられることがない。さらに、キャリッジ8の左右方向への移動に伴いヘッドホルダ18も左右方向に移動することになるので、ヒートシンク27と回路基板26との隙間には、空気が流れ、ヒートシンク27からの放熱効果を高めることができる。

[0030]

次に、図8及び図9を参照して、ヒートシンク27とICチップ38が搭載されたフレキシブル配線基板34との間に異物53が挟まった場合について説明する。図9は、ヒートシンク27とフレキシブル配線基板34との間に、異物53が挟まった状態を示す拡大断面図である。上記の構成のインクジェットプリンタ1では、図8及び図9に示すように、ヒートシンク27の当接部27kとICチップ38との間に熱伝導が良く、可撓性を有する絶縁体である樹脂(一例として、ポリイミド樹脂)からなるフレキシブル配線基板34が介在するので、ヒートシンク27の当接部27kとフレキシブル配線基板34が介在するので、ヒートシンク27の当接部27kとフレキシブル配線基板34との間に異物53が挟まってもフレキシブル配線基板34が撓み、異物53がフレキシブル配線基板34にめり込み、ICチップ38に局所的な力がかかることが無い。従って、異物53の噛込によるICチップ38の破損を防止できる。

[0031]

また、異物53が、ヒートシンク27の当接部27kとフレキシブル配線基板34との間に介在しても、異物53がフレキシブル配線基板34にめり込むので、ICチップ38は、フレキシブル配線基板34を介してヒートシンク27の当接部27kに密着することができる。従って、ICチップ38からヒートシンク27への伝熱性能が悪化することがない。さらに、ICチップ38の表面とヒートシンク27との間には、絶縁体であるフレキシブル配線基板34が介在し、また、樹脂カバー24もしくは弾性部材50が絶縁体であることで、印字に影響する電気的ノイズがICチップ38で発生しても、他のICチップ35~37に当該電気的ノイズが伝播することを防止できる。

[0032]

尚、本発明は、上記の実施の形態に限られず、各種の変形が可能である。例えば、本発明は、記録ヘッドにプレート型圧電アクチュエータを用いたプリンタに

限られず、記録ヘッドを駆動する駆動素子を備えたもので有れば、各種のプリンタに適用できる。また、記録ヘッドを駆動する駆動素子の数は、4つに限られず、2個、6個等の任意の数のものに適用できる。

[0033]

【発明の効果】

以上、詳述したとおり、請求項1に係る発明の記録装置では、ヒートシンクは、駆動素子が設けられたフレキシブル配線基板の面と反対側の面の駆動素子に対向する位置に密着されており、ヒートシンクがフレキシブル配線基板に密着する面に異物が介在しても、フレキシブル配線基板は可撓性を有する絶縁体であるので、当該異物は、フレキシブル配線基板の面にめり込みヒートシンクは駆動素子が設けられたフレキシブル配線基板の面と反対側の面に密着することができる。従って、駆動素子に局所的な力がかかることが無く、駆動素子の破損を防止できる。また、駆動素子からヒートシンクへの伝熱性能を良好に達成することができる。

[0034]

また、請求項2に係る発明の記録装置では、請求項1に記載の発明の効果に加えて、フレキシブル配線基板とヘッドホルダとの間に設けられたヒートシンクに対して、ヘッドホルダに設けられたカバーと駆動素子との間に設けられた弾性部材の押圧力により、駆動素子はフレキシブル配線基板を挟んでヒートシンクに押圧されるので、駆動素子とヒートシンクとはフレキシブル配線基板を挟んで密着することができ、伝熱性能を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、インクジェットプリンタ1の内部構造を示す斜視図である。

【図2】

図2は、記録ヘッドユニット17を、その底部の背面側から見た斜視図である

【図3】

図3は、記録ヘッドユニット17から樹脂カバー24を取り去った状態を示す

斜視図である。

【図4】

図4は、記録ヘッドユニット17の分解斜視図である。

【図5】

図5は、ヘッドホルダ18の斜視図である。

【図6】

図6は、ヒートシンク27の平面図である。

【図7】

図7は、A-A'線における断面図である。

【図8】

図8は、A-A'線における断面のICチップ38近傍の拡大断面図である。

【図9】

図9は、ビートシンク27とフレキシブル配線基板34との間に、異物53が 挟まった状態を示す拡大断面図である。

【符号の説明】

- 1 インクジェットプリンタ
- 2 筐体
- 7 a ~ 7 h 噴射ノズル群
- 8 キャリッジ
- 17 記録ヘッドユニット
- 18 ヘッドホルダ
- 18a 底壁
- 18b 背壁
- 19~22 記録ヘッド
- 24 樹脂カバー
- 26 回路基板
- 27 ヒートシンク
- 27a~27d 凹部
- 2 7 k 当接部

28 ヘッド保持部

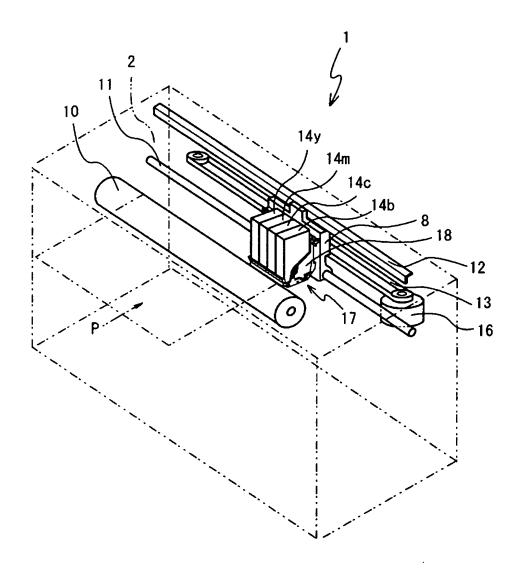
31~34 フレキシブル配線基板

35~38 ICチップ

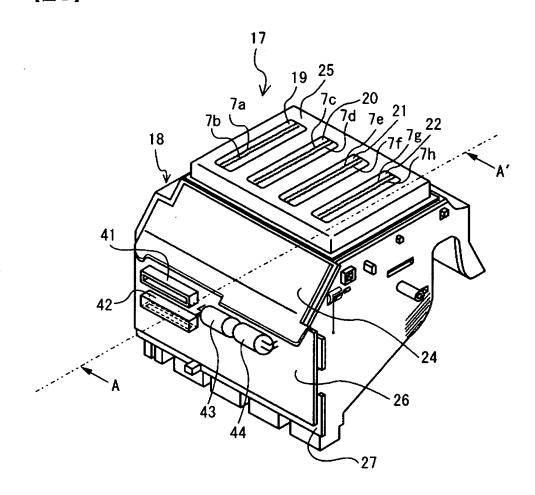
5 3 異物

【書類名】 図面

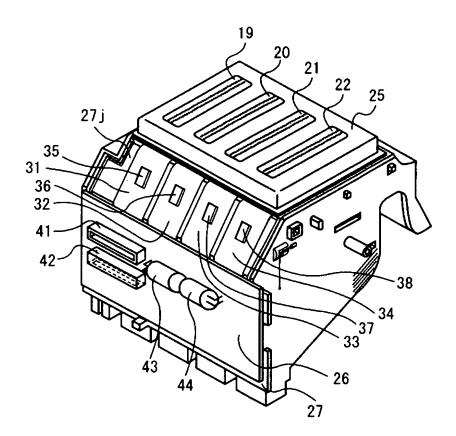
【図1】



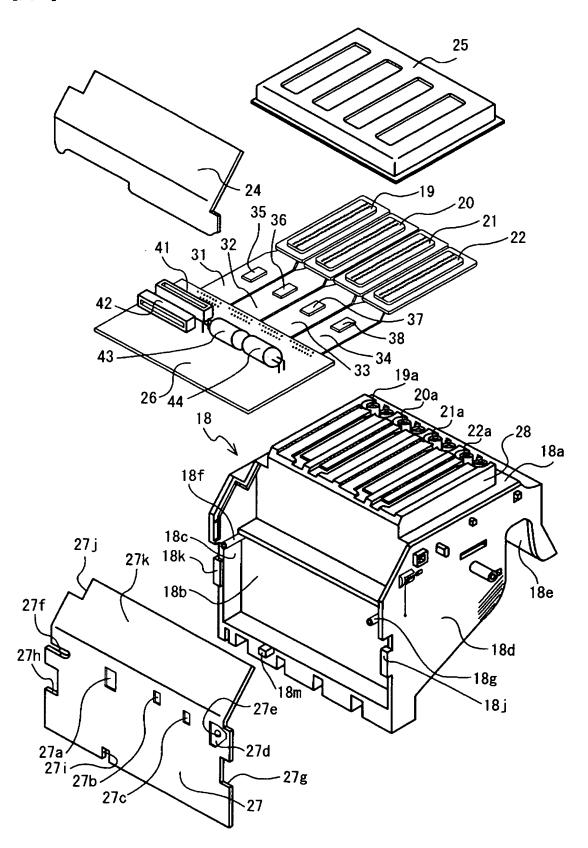
【図2】



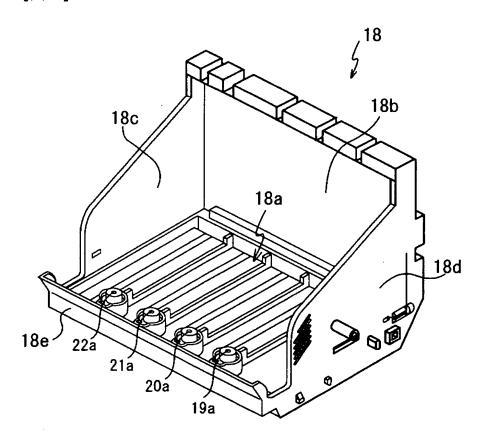
【図3】



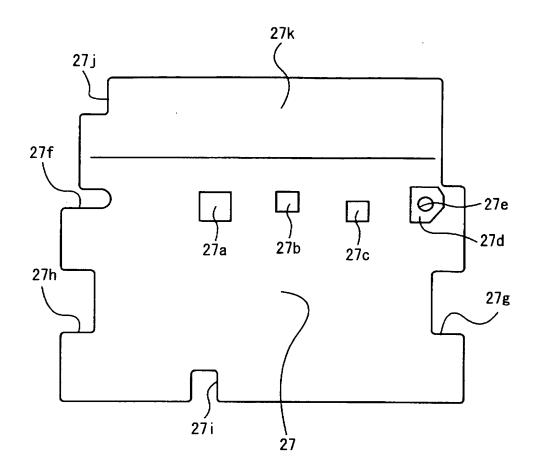
【図4】



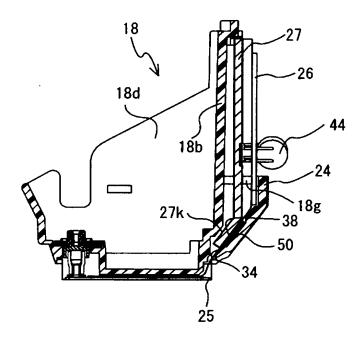
【図5】



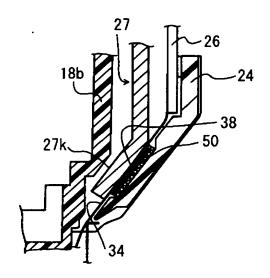
【図6】



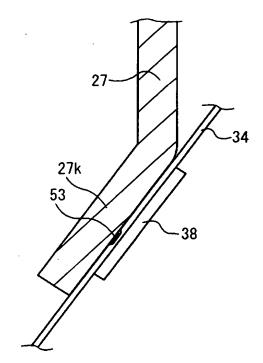
【図7】



【図8】



【図9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】・ドライバICチップとヒートシンクとの間に異物が介在しても、ドライバICチップの破損を防止でき、また、これらの密着性を高め、良好な放熱効果を達成することができ、さらに、複数のドライバICチップ間でノイズが互いに伝播することのない記録装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 ヒートシンク27の当接部27kとICチップ38との間に熱 伝導が良く可撓性を有する絶縁体である樹脂からなるフレキシブル配線基板34 が介在するので、ヒートシンク27の当接部27kとフレキシブル配線基板34 との間に異物53が挟まってもフレキシブル配線基板34が撓み、ICチップ3 8に局所的な力がかかることが無く、異物53の噛込によるICチップ38の破 損を防止でき、密着性も向上できる。

【選択図】 図9

特願2003-089899

出願人履歴情報

識別番号

[000005267]

1. 変更年月日

1990年11月 5日

[変更理由]

住所変更

住 所

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号

氏 名 ブラザー工業株式会社